制作 李波 证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021年10月15日 星期五

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-108

天津广宇发展股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩:亏损

项 目	2021年1月1日-2021年9月30日	2020年1月1日-2020年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约54,011.31万元-106,511.31万元	盈利:191,030.28万元
	比上年同期下降:约128.27%-155.76%	
基本每股收益	亏损:约0.29元/股-0.57元/股	盈利:1.03元/股

其中,2021年第三季度预计业绩情况:

项目	2021年7月1日-2021年9月30日	2020年7月1日-2020年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约149,023.06万元-201,523.06万元	盈利:53,196.29万元
	比上年同期下降:约380.14%-478.83%	
基本每股收益	亏损:约0.80元/股-1.08元/股	盈利:0.29元/股

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降,主要原因是:(1)因受国内宏观经济环境、房地产行业环境、房地产调控信贷政策等因素叠加影响,本期交付项目数量、结转收入、利润较上年同期下降。(2)公司积极拓展业务规模,新获取项目尚处于前期开发阶段,由于房地产行业结转收入呈现周期性,公司前期投入尚未达到结转条件。(3)公司借款增加,费用化利息增加。(4)公司近期正积极推进重大资产置换事项,根据对所属单位资产的预评估,预计存货等资产存在减值迹象,减值金额约22亿元-29亿元,减少归属于上市公司股东的净利润约16.50亿元-21.75亿元,具体减值金额需根据最终评估结果确定。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司初步估算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据请以公司披露的2021年第三季度报告为准。

2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021年10月15日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-109

天津广宇发展股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"广宇发展")拟将所持全部23家子公司股权、应收款项及负债与鲁能集团有限公司(以下简称"鲁能集团")、都城伟业集团有限公司(以下简称"都城伟业")合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称"鲁能新能源")100%股权进行资产置换,估值差额部分由交易对方以现金方式向上市公司补足。(以下简称"本次重组"或"本次交易")

2.本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资产重组。

3.本公司因筹划重大资产重组事项,避免对公司股价造成重大影响,公司已于2021年9月6日发布《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》。

4.根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组信息公布前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。

5.公司郑重提示投资者注意投资风险。

一、本次交易方案

(一)交易对方

本次交易的交易对方为鲁能集团、都城伟业。

(二)标的资产

本次交易中的置出资产为广宇发展所持全部23家子公司股权、应收款项及负债,置入资产为交易对方共同持有的鲁能新能源100%股权。(鲁能集团已实施对鲁能新能源的增资,增资完成后鲁能集团预计持有鲁能新能源18.64%股权,都城伟业预计持有鲁能新能源81.36%股权。目前,上述增资事项正履行工商变更登记程序,鲁能新能源股权结构以最终工商登记为准。)

待本次交易的审计评估工作完成后,对于置出、置入资产交易对价的差额部分,将以现金方式补足。

(三)交易方式

上市公司拟将截至评估基准日的全部23家子公司股权、应收款项及负债作为拟置出资产,与鲁能集团、都城伟业合计持有的鲁能新能源100%股权进行置换,估值差额部分由交易对方以现金方式向上市公司补足。

上市公司将全部23家子公司股权置出给鲁能集团、都城伟业的方案尚待审计评估结果进一步确定。

本次交易完成后,上市公司将持有鲁能新能源100%股权。

提请投资者关注,本次资产置换尚处于筹划阶段,具体交易的资产范围、交易方案尚待审计评估工作完成后最终确定。

二、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市,构成关联交易

(一)本次交易构成重大资产重组

相关标的资产的审计评估工作正在开展,尚未形成最终结果。

根据预评估情况,截至评估基准日上市公司拟置出23家子公司较账面净资产合计增值约17亿元-22亿元,具体金额需根据最终评估结果确定,本次交易将以评估机构出具且经有权国资管理单位备案的评估报告作为最终交易定价依据。

根据上市公司2021年10月15日公告的《2021年前三季度业绩预告》(公告编号:2021-108),上市公司根据对所属单位资产的预评估,预计存货等资产存在减值迹象,减值金额约22亿元-29亿元,具体减值金额需根据最终评估结果确定。

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司同时购买、出售资产的,应当分别计算购买、出售资产的相关比例,并以二者中比例较高者为准。由于本次交易中上市公司置出全部子公司股权及负债,本次交易构成重大资产重组。

(二)本次交易不构成重组上市

本次交易不涉及上市公司股份变动。本次交易前后,上市公司的实际控制人不会发生变化,均为国务院国资委。

本次交易不会导致公司控制权的变更,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

(三)本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方鲁能集团为上市公司控股股东,都城伟业为上市公司间接控制人中国绿发投资集团有限公司(以下简称"中国绿发")的全资子公司,亦为上市公司的关联方。本次交易构成关联交易。

三、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司业务的影响

本次交易完成前,上市公司的主要业务为房地产开发与销售。

通过本次交易,上市公司将原有房地产业务资产置出,同时置入行业前景良好的新能源发电业务。本次交易完成后,上市公司将持有鲁能新能源100%股权。上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及上市公司股份变动,交易前后上市公司股权结构不发生变化。

(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

关于置入标的鲁能新能源,根据未经审计财务数据,截至2021年6月末,置入标的总资产为341.45亿元,净资产为102.82亿元。2021年1-6月,营业收入为17.57亿元,扣除非经常性损益后的净利润为6.37亿元。

关于上市公司,根据未经审计财务数据,截至2021年6月末,上市公司总资产为795.59亿元,净资产为164.09亿元。2021年1-6月,上市公司营业收入为99.00亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.15亿元。

本次交易对上市公司主要财务指标的影响,尚待审计评估工作完成后进一步确定。

四、本次交易决策过程和批准情况

(一)本次交易已履行的程序

1.本次交易相关事项已获得间接控股股东中国绿发的原则性同意;

(二)本次交易尚需履行的程序

本次交易方案尚需获得的批准和核准,包括但不限于:

1.交易对方内部决策通过本次交易正式方案;

2.本次交易方案及相关议案获得上市公司董事会审议通过;

3.本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国资部门备案;

4.有权国资管理单位就本次交易方案出具正式批复;

5.上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案;

6.相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

五、风险提示

本次重组尚处于筹划阶段,具体交易的方案、交易价格等要素均未最终确定,提请投资者关注以下风险:

(一)本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次重组的具体方案细节尚在进一步细化和多方论证中。由于本次重组将受到多方因素的影响且本次重组方案的确定和实施尚须满足多项前提条件,故本次重组工作时间进度存在一定的不确定性。本次重组可能因为以下事项的发生而被暂停、中止或取消,提请投资者注意相关风险。

1.本次重组拟注入标的资产业绩发生大幅下滑或出现不可预知的重大影响事项;

2.在未来重组工作进程中出现"本次交易相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查"的情形;

3.其他原因可能导致本次重组被中止或取消;

公司董事会将在本次重组过程中及时公告相关工作进展,以便投资者了解交易进度并作出相应判断。

(二)审批风险

本次重组方案尚需获得相关批准或核准,详见"四、本次交易决策过程和批准情况"之"(二)本次交易尚需履行的程序"。

本次重组能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,因此,本次重组能否最终成功实施存在不确定性,提请投资者注意本次重组的审批风险。

(三)已披露的置出、置入资产财务数据与审计结果存在差异的风险

截至本公告披露日,本次重组涉及的置出、置入资产的审计、评估工作尚未完成,置出、置入资产经审计的财务数据最终结果可能与披露情况存在差异,特提请投资者关注。

在本次重组相关的审计、评估工作完成后,公司将召开董事会会议审议相关事项,编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。置出、置入资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。

(四)股价波动风险

上市公司的股价不仅由公司的经营业绩和发展战略决定,还受到宏观经济形势变化、国家经济政策的调整、股票市场等众多不可控因素的影响。针对上述情况,上市公司将根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露可能影响股票价格的重大信息,供投资者作出判断。

(五)业绩被摊薄的风险

本次重组完成后,若置入标的在未来经营中出现业绩下滑、亏损等情形,则可能导致上市公司即期回报被摊薄的情况。同时,受宏观经济、行业政策、竞争环境、新冠疫情等多方面未知因素的影响,重组后的上市公司在经营过程中将面临一系列风险,可能对上市公司的经营成果产生重大不利影响,进而导致上市公司经营效益不及预期,上市公司每股收益面临被摊薄的风险。

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排

(一)严格履行上市公司信息披露义务

公司及相关信息披露义务人将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的相关要求,切实履行信息披露义务,及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司将继续按照相关法规的要求,真实、准确、完整地披露本次交易的进展情况。

(二)确保本次交易标的资产定价公允

上市公司已聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估,并由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确意见,以确保本次交易标的资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公司股东利益。

(三)股东大会及网络投票情况

公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,就本次交易方案的表决提供网络投票平台,为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。

(四)其他保护投资者权益的措施

1. 上市公司保证就本次交易向相关中介机构提供的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)以及为本次交易所出具的说明及确认均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,有关文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,文件资料上的所有签字与印章均真实、有效。

2.在本次交易期间,上市公司将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定,及时披露有关本次交易的信息并提交有关申报文件,并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性,并承诺如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承诺承担个别和连带的法律责任。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021年10月15日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-075

深圳同兴达科技股份有限公司 2021年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年9月30日

2.预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:32,000万元—36,000万元	盈利:17,093.72万元
	比上年同期增长:87.20%—110.60%	
基本每股收益	盈利:1.37元/股-1.54元/股	盈利:0.84元/股

注:以上数据均精确到小数点后2位。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司经过多年的深耕细作,已成长为行业头部企业,与多家全球终端品牌厂商及龙头面板厂达成了战略合作关系,大客户集中度更高,市场占有率逐渐提高,2021年随着业务量的不断上升,实现了营业收入和盈利水平双向持续增长;

2、公司持续推进高端智慧工厂建设,目前已达成第一阶段目标,智慧工厂管理规范度高、生产效率高、产品质量优,工厂生产效率及产品良率居于行业领先水准,公司产品效益的增加及成本的下降,带来盈利能力的增强。

3、显示触控群方面,公司于2020年扩充了OLED智能穿戴和中大尺寸触显一体化模组高端生产线,进一步增强公司在规模和技术创新等方面的优势,不断增强公司的盈利能力和核心竞争力,为公司利润带来新的增长点。

4、光学摄像群方面,公司在现有客户的基础上,持续开拓市场,优化客户结构,一方面继续深耕手机领域,加强与主要品牌终端的合作;另一方面,成功拓展了全球知名平板电脑客户;此外,公司还进一步丰富产品应用领域,现已成为国内领先无人机品牌的主力供应商;带动光学摄像群的业绩持续增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的2021年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-074

深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,现将公司2021年第三次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2021年11月1日下午14:30。

网络投票日期、时间:2021年11月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月1日9:15-15:00任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:10月25日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2021年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三。

二、会议审议事项

1、《关于设立全资子公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2021年10月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。

上述议案为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一 股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于设立全资子公司的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东由其法定代表人出席的,凭本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2021年10月29日(上午10:00-12:00;下午14:00-18:00)

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼16层证券部

邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com(信函上请注明"股东大会"字样)。

五、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:宫兰芳

电话:0755-33687792 邮箱:zqswdb@txdkj.com

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362845";投票简称为"TX投票"。

2、填报表决意见或表决票数:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年11月1日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹全权委托________先生/女士代表本单位(本人)出席2021年11月1日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于设立全资子公司的议案》				

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。如果股东不作具体指示的,股东代理人以按自己的意思表决;

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-072

深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"同兴达")于2021年9月30日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2021年10月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长万锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,并提交公司股东大会审议。

经审议,董事会认为本次对外投资设立全资子公司符合公司的战略发展规划,如能顺利实施,将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生影响,有利于公司的长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

二、审议并通过了《公司关于签订项目合作框架协议的议案》

经审议,董事会同意公司与日月光半导体(昆山)有限公司签订项目合作框架协议。按照项目总投资金额,双方共同出资,合作"芯片先进封测(Gold Bump)全流程封装测试项目"。实现优势互补,提升公司的盈利能力,增强公司核心竞争力,符合公司发展战略及全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于签订项目合作框架协议的公告》(公告编号:2021-070)。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

三、审议并通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月1日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会,审议以上议案。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-076

深圳同兴达科技股份有限公司关于公司向子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"深圳同兴达"或"公司")及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》,并于2021年5月24日召开的2020年度股东大会审议通过。为保证公司子公司2021年项目顺利开展,根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下简称"赣州电子")、南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称"南昌精密")、南昌同兴达智能显示有限公司(以下简称"南昌显示")、同兴达(香港)贸易有限公司(以下简称"香港同兴达")、赣州市展宏新材科技有限公司(以下简称"展宏新材")提供总计不超过人民币47.5亿元的银行授信担保,总计不超过人民币12.5亿元的履约担保,总额度不超过人民币60亿元。具体明细如下:

担保方	被担保方	授信担保额度(亿)	履约担保额度(亿)
深圳同兴达	赣州电子	30	7
深圳同兴达	南昌精密	12	4
深圳同兴达	南昌显示	3	1
深圳同兴达	香港同兴达	1	0.5
深圳同兴达	展宏新材	1.5	0
小计		47.5	12.5
合计		60	

上述事项自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

以上事项具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-018、2021-032)。

二、担保进展情况

近日,公司与九江银行股份有限公司赣州分行(简称"九江银行")签署了《最高额保证担保合同》,分别为子公司赣州电子提供了人民币10,500万元的融资授信额度连带责任保证担保,为南昌精密提供了人民币1,5000万元的融资授信额度连带责任保证担保,为南昌显示提供了人民币1,000万元融资授信额度连带责任保证担保;

公司与中信银行股份有限公司赣州分行(简称"中信银行")签署了《最高额保证担保合同》,为子公司赣州电子申请了人民币8,000万元融资授信额度连带责任担保。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次使用担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
同兴达	赣州电子	100%	71.25%	126,393.44	18,500	6.49%	是
同兴达	南昌精密	61.13%	65.78%	61,424.75	15,000	5.26%	是
同兴达	南昌显示	100%	92.37%	13,000.00	1,000	0.35%	是

注:上表中最近一期指2021年6月30日,未经审计。

三、被担保人基本情况

1、赣州市同兴达电子科技有限公司

成立日期:2011-08-23

法定代表人:万锋

地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号

注册资本:130,000万人民币

经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

信用等级情况:赣州电子信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、南昌同兴达精密光电有限公司

成立日期:2017-09-08

法定代表人:梁甫华

地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路299号4#厂房

注册资本:49,075.63万人民币

经营范围:光学元器件制造、销售和技术服务;机械设备租赁;精密模具的制造;电子产品、检测设备批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:南昌精密系本公司控股子公司,公司持有其61.13%股权。

信用等级情况:南昌精密信用状况良好,不属于失信被执行人。

3、南昌同兴达智能显示有限公司

成立日期:2017-09-08

法定代表人:邓新强

地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路299号5#厂房

注册资本:10,000万人民币

经营范围:显示器件、光电子器件和组件研发、制造、销售及技术服务。国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:南昌显示系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)被担保人财务状况:

被担保人截止2020年12月31日的财务状况如下(已经审计):

单位:万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
赣州电子	100%	412,836.23	321,752.01	91,084.22	447,193.27	18,955.89	16,812.02
南昌精密	61.13%	211,319.12	149,138.43	62,180.69	206,333.91	4,842.60	4,728.51
南昌显示	100%	170,719.16	157,850.75	12,868.41	312,167.25	3,228.38	2,421.28

被担保人截止2021年6月30日的财务状况如下(未经审计):

单位:万元

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
赣州电子	100%	588,135.75	419,021.31	169,114.44	470,827.85	19,366.15	17,670.33
南昌精密	61.13%	188,166.79	123,767.91	64,398.87	102,090.52	1,800.78	2,218.18
南昌显示	100%	153,026.55	141,343.71	11,682.84	206,246.35	-1,573.02	-1,179.76

四、担保协议主要内容

被担保人	担保人	债权人	担保额度(万元)	担保期限	担保/反担保内容
赣州电子	深圳同兴达	九江银行	10,500	主合同约定的债务履行期限届满之日后三年	担保方式:连带责任保证 主要担保范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履约金,以及诉讼仲裁费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
赣州电子	深圳同兴达	中信银行	8,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	担保方式:连带责任保证 主要担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括不限于诉讼、仲裁等)和其他所有应付的费用。
南昌精密	深圳同兴达	九江银行	15,000	主合同约定的债务履行期限届满之日后三年	担保方式:连带责任担保 主要担保范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履约金,以及诉讼仲裁费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
南昌显示	深圳同兴达	九江银行	1,000	主合同约定的债务履行期限届满之日后三年	担保方式:连带责任担保 主要担保范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履约金,以及诉讼仲裁费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

五、董事会意见

本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。公司对提供担保的子公司具有实质控制权,被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控。且被担保对象南昌精密的其他股东均与银行签署了同比例的担保协议。本次担保对象为合并报表范围内的子公司,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日,公司2021年经审议的对外担保总额度为600,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为228.82%。

2、截止本公告日,公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额(即担保总余额)为人民币212,069.43万元,占公司经审计的最近一期净资产的比例为80.88%。

3、公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-071

深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况:

为满足公司战略发展需要,近日深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")与日月光半导体(昆山)有限公司(以下简称"昆山日月光")签订了《项目合作框架协议》,公司拟在昆山投资设立全资子公司昆山同兴达半导体有限责任公司(名称暂定,以下简称" 同兴达半导体 "),注册资金为7.5亿元人民币。用来实施"芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目"(简称"Gold Bump封测")项目,有助于公司向产业链前端领域延伸布局,提升公司的综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2021年9月30日以书面及通讯方式发出,董事会于2021年10月14日召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,表决结果以7票赞成,0票反对,0票弃权通过本议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易:本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式:以现金方式出资;

2、资金来源:公司自有或自筹资金;

3、投资方的基本情况:

企业名称:深圳同兴达科技股份有限公司;

企业住所:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2号楼1301-1601;

企业类型:股份有限公司;

法定代表人:万锋;

注册资本:23431.4304万元人民币;

主营业务:一般经营项目是:电子产品的技术开发、生产及销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目);

4、标的公司基本情况:

公司名称:昆山同兴达半导体有限责任公司(暂定,具体以工商核定为准);

企业类型:有限责任公司;

住所:江苏省昆山市千灯镇(暂定);

法定代表人:万锋(暂定);

注册资本:7.5亿人民币;

投资人的投资规模和持股比例:由公司出资7.5亿元人民币独资设立,持股比例100%;

同兴达半导体的经营范围:从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售,计算机系统集成,货物或技术进出口(暂定,具体以工商核定为准)。

5.项目情况

项目名称:昆山同兴达半导体有限责任公司(暂定,具体以工商核定为准)

项目投资的具体内容:打造全流程Gold Bump(金凸块)+CP测试+COF/COG(一期)

投资总额及进度:待股东大会审议通过后,按照"芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目"总投资金额,双方分别出资,具体投资金额及出资比例以双方后续实际合作及项目进度情况为准。

项目投资领域基本情况:公司与昆山日月光为充分发挥各自优势,公司特投资设立子公司,共同合作"芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目",芯片封装位于芯片制造产业链后端。目前传统封装面临诸多瓶颈、先进制程逼近物理极限,而先进封装可以相对容易的实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。

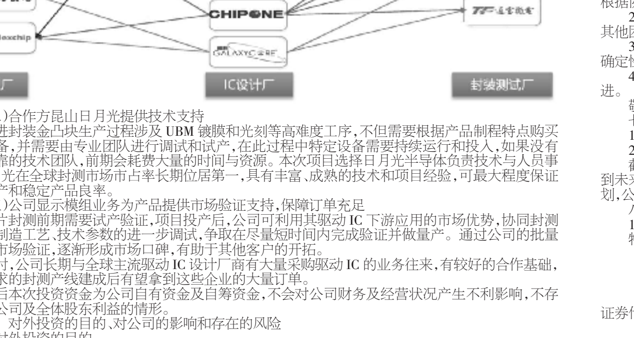
Gold Bump封测项目投资的可行性分析:

(一)先进封测领域市场空间广阔,目前为最佳进入时机

先进封装尤其是倒装芯片市场规模广阔。根据Yole预测,2025年先进封装的占比将提升至整体封测行业的49.4%,其中倒装为先进封装中最大市场。2018年先进封装市场规模约为280亿美元,其中倒装市场规模约224亿美元,占比达80%,2018-2024年的CAGR为6%。

数据来源:Yole

中国大陆Gold Bump封测产能较少,目前是进入此细分市场的最佳时机。全球芯片市场主要IC设计、晶圆代工、封测厂商如下图:



(二)合作方昆山日月光提供技术支持

先进封装金凸块生产过程涉及UBM镀膜和光刻等高难度工序,不但需要根据产品制程特点购买配套设备,并需要由专业团队进行调试和试产,在此过程中特定设备需要持续运行和投入,如果没有专业可靠的技术团队,前期会耗费大量的时间与资源。本次项目选择日月光半导体负责技术与人员事项,日月光在全球封测市场市占率长期位居第一,具有丰富、成熟的技术和项目经验,可最大程度保证快速量产和稳定产品良率。

(三)公司显示模组业务为产品提供市场验证支持,保障订单充足

芯片封测前期需要试产验证,项目投产后,公司可利用其驱动IC下游应用的市场优势,协同封测厂进行制造工艺、技术参数的进一步调试,争取在尽量短时间内完成验证并做量产。通过公司的批量采购和市场验证,逐渐形成市场口碑,有助于其他客户的开拓。

同时,公司长期与全球主流驱动IC设计厂商有大量采购驱动IC的业务往来,有较好的合作基础,满足要求的封测产线建成后有望拿到这些企业的大量订单。

最后本次投资资金为公司自有资金及自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的:

本次公司投资设立子公司主要用于实施先进封测项目,契合同兴达的战略发展规划,有助于公司向产业链前端领域延伸布局,开阔新的业绩增长点,从而提高公司综合竞争力,提升经营效益与盈利水平。其次封测项目与公司主营业务具有协同效应,公司主营显示模组和光学摄像模组,原材料包括驱动IC和CIS芯片。封测项目可加强与上游芯片企业联系,一定程度保障模组业务的芯片供应,同时可降低部分采购成本,增强公司盈利能力。

2、对外投资对公司的影响

本次新设全资子公司,是结合公司现有的产业基础和竞争实力,为了进一步实现产品升级和拓展公司新业务领域,提高公司核心竞争力,满足市场及客户需求,服务于公司未来发展战略需要。本次对外投资设立全资子公司符合上市公司全体股东的长远利益,不会对公司的发展战略造成不利影响,而且本次投资以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

3、对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司事项尚需提交当地工商行政管理部门登记/核准,具有一定的不确定性。公司能够对标的公司实施有效控制,但未来经营受到政策环境、市场环境等多方面因素的影响。

公司会加强对行业经济、产业政策的研判,密切关注该子公司的经营管理,组建良好的经营管理团队,督促其规范运作,加强风险控制,力争达到预期设想的战略目标。相关事项若有后续重大进展或变化,公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-070

深圳同兴达科技股份有限公司关于签订项目合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本《项目合作框架协议》为意向性协议,所涉事项须经双方协议确定的原则后,根据相关规定另行签署正式协议或合同。

2、因本协议项下的具体合作项目实施合同尚未签订,本协议的签订暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")近日与日月光半导体(昆山)有限公司(以下简称"昆山日月光")在深圳签订了《项目合作框架协议》,按照项目总投资金额,双方分别出资,合作"芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目"。具体投资金额及各自出资金额比例以双方后续实际合作及项目进度情况为准。具体情况如下:

一、协议的基本情况

(一)协议签订的基本情况

基于公司长期专注电子配件制造业,对智能制造工厂管理系统和平台有积累较好的经验,昆山日月光深耕半导体封装测试行业多年,具有丰富、成熟经验与技术团队。双方充分发挥各自优势,为实现互利、共赢,双方分别出资,合作"芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目"。

日月光投资控股股份有限公司(以下简称"日月光集团")为客户提供半导体封装、测试、电子代工制造服务,在2003年已成为全球最大的半导体集成电路封装测试服务公司,并持续十多年保持同行业龙头位置。在全球封装测试产业中,拥有最完整的供应链系统,昆山日月光为日月光集团下属子公司。本次公司与日月光团队达成项目合作,有助于公司向产业链前端领域延伸布局,开阔新的业绩增长点,从而提高公司综合竞争力,提升经营效益与盈利水平。

本《项目合作框架协议》为公司日常经营合同,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

(二)协议对方的基本情况

1、公司名称:日月光半导体(昆山)有限公司

2、法定代表人:徐世康

3、经营范围:生产高密度印刷电路板(BGA基板)及光电子器件等新型电子元器件。半导体(硅片及化合物半导体)集成电路元器件及分离式元器件(包含闸流体、两端子闸流体、三端子闸流体等电子产品,光敏装置除外)的封装及测试,封装型式的设计开发,测试程序的设计开发,提供晶圆针测,可靠性测试服务(国家限制类及禁止类项目除外)。生产供输送或包装集成电路产品之塑料盘。生产其它集成电路及微电子组件零件(晶体管、二极管用引线丁架,集成电路用引线丁架)。销售自产产品,并提供相关的技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、设立时间:2004年8月16日

5、注册地址:江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央大道北侧。

6、日月光半导体(昆山)有限公司与公司不存在关联关系,不构成关联交易,且本次交易为双方首次合作。

7、履约能力分析:日月光经营状况、财务状况和资信情况良好,具有良好的信用和较强的履约能力。

二、签订协议需履行的审议决策程序

本协议的签署已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。双方在涉及到后续具体合作事宜,将就具体事项另行商洽签订协议,公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定,履行相应的决策和审批程序。

三、协议的主要内容

(一) 签约主体

甲方:深圳同兴达科技股份有限公司

乙方:日月光半导体(昆山)有限公司

(二)合作原则

1、合作双方在推进合作过程中,必须遵守国家的各项法律、法规和政策,符合国家产业发展导向及产业政策。

2、合作双方遵循"合作、发展、效率"宗旨,通过双方的努力,实现战略合作的高效、优质、快速开展。

(三)合作目标

甲乙双方以项目合作模式共同打造"芯片金凸块(Gold Bump)全流程封装测试项目",从而在中国大陆建立卓越先进的高端封装技术的Gold Bump封测公司。

(四) 合作方式

公司成立子公司,与昆山日月光项目合作方式进行合作。

(五)合作内容

为实现合作目标,本协议项下双方合作的内容为Gold Bump全流程封装测试项目的建设和运营,项目一期将建成月产能2万片12寸全流程Gold Bump(金凸块)生产工厂。

本合作内容仅为甲乙双方初步合作意向,具体合作内容及法律相关的权利义务以签订的正式合同为准。

(六)权利和义务

涉及合作项目的具体权利义务将在正式签订的合同中约定。

四、协议对公司的影响

(一)进军新领域,增强公司综合实力

作为先进封装芯片下游直接应用厂商,公司深刻了解先进封装技术在显示驱动IC中的重要作用,并看好其长期发展前景。国内面板不断扩大产能,驱动芯片的需求量随之增长,封测项目投资着眼于为国内面板产业提供完整的驱动IC供应链,发展卓越先进的高端封装技术,提升同兴达未来综合竞争力。

(二)向产业上游延伸,加大与上游供应商合作深度

建设封测产线是公司向前端制造领域延伸。在目前的业务模式下,上游驱动IC设计公司多采用Fabless模式,将晶圆生产和封装测试等环节分别外包。公司与全球主流驱动IC设计公司长期建立良好的合作关系,建成封测产线后可承接上游驱动IC设计公司拿到晶圆后的封测订单,进一步加深与上游公司合作关系。

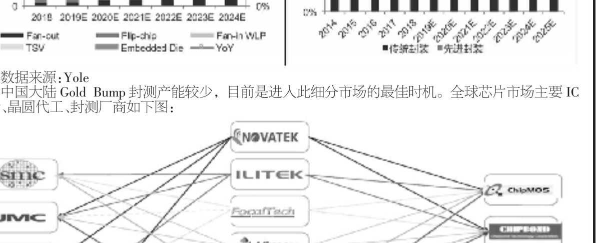
(三)封测项目与公司主营业务具有协同效应

公司主营显示模组和光学摄像模组,原材料包括驱动IC和CIS芯片。封测项目可加强与上游芯片企业联系,一定程度保障模组业务的芯片供应,同时可降低部分采购成本,增强公司盈利能力。

五、项目建设的可行性

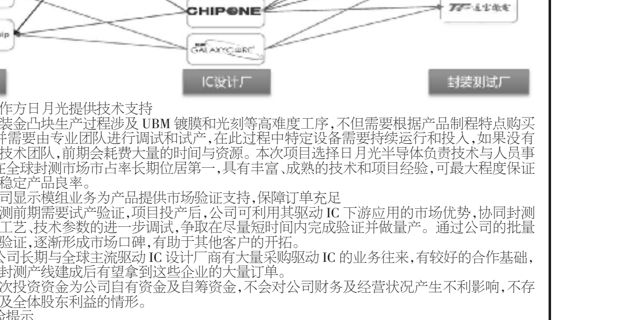
(一)先进封测领域市场空间广阔,目前为最佳进入时机

先进封装尤其是倒装芯片市场规模广阔。根据Yole预测,2025年先进封装的占比将提升至整体封测行业的49.4%,其中倒装为先进封装中最大市场。2018年先进封装市场规模约为280亿美元,其中倒装市场规模约224亿美元,占比达80%,2018-2024年的CAGR为6%。



数据来源:Yole

中国大陆Gold Bump封测产能较少,目前是进入此细分市场的最佳时机。全球芯片市场主要IC设计、晶圆代工、封测厂商如下图:



(二)合作方日月光提供技术支持

先进封装金凸块生产过程涉及UBM镀膜和光刻等高难度工序,不但需要根据产品制程特点购买配套设备,并需要由专业团队进行调试和试产,在此过程中特定设备需要持续运行和投入,如果没有专业可靠的技术团队,前期会耗费大量的时间与资源。本次项目选择日月光半导体负责技术与人员事项,日月光在全球封测市场市占率长期位居第一,具有丰富、成熟的技术和项目经验,可最大程度保证快速量产和稳定产品良率。

(三)公司显示模组业务为产品提供市场验证支持,保障订单充足

芯片封测前期需要试产验证,项目投产后,公司可利用其驱动IC下游应用的市场优势,协同封测厂进行制造工艺、技术参数的进一步调试,争取在尽量短时间内完成验证并做量产。通过公司的批量采购和市场验证,逐渐形成市场口碑,有助于其他客户的开拓。

同时,公司长期与全球主流驱动IC设计厂商有大量采购驱动IC的业务往来,有较好的合作基础,满足要求的封测产线建成后有望拿到这些企业的大量订单。

最后本次投资资金为公司自有资金及自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本战略合作协议系签约双方合作意愿的框架性、意向性、指导性文件,所涉事项将由协议各方根据协议确定的原则和相关规定另行签署正式协议或合同。

2、合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场开拓与波动、财务等方面可能存在的其他困难、不确定性或风险。

3、本次项目合作为公司首次进入新的业务领域,后续的合同执行及对公司的业绩的影响具有不确定性。

4、此次签订框架协议对公司当期业绩不存在重大影响情况。具体实施内容和进度公司会持续推进。

敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

七、其他相关说明

1、公司最近三年不存在披露过框架性协议或意向性协议的情况。

2、公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况:

截至本公告披露日,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在持股变动情况,公司亦未收到未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高减持股份的通知。若未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、《项目合作框架协议》

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-073

深圳同兴达科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"同兴达")于2021年9月30日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2021年10月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱长隆先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,并提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司此次对外投资成立全资子公司是基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要,有利于公司的长远发展,对公司的整体实力和综合竞争力的提升产生积极影响。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对:0票。

二、审议并通过了《公司关于签订项目合作框架协议的议案》

经审核,监事会认为:公司与日月光半导体(昆山)有限公司签订项目合作框架协议。按照项目总投资金额,双方共同出资,合作"芯片先进封测(Gold Bump)全流程封装测试项目",能够实现优势互补,提升公司的盈利能力,增强公司核心竞争力,符合公司发展战略及全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于签订项目合作框架协议的公告》(公告编号:2021-070)。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
监事会
2021年10月14日